# Dispositifs à transfert de charges

- •CCD
- •BCCD
- PCCD
- •CCIS
- •CID
- et capteurs MOS



### Introduction



- Utilisation du temps de stockage d'une capacité MOS
- Mis à profit pour injecter (électriquement ou optiquement) hors équilibre des charges.
- Une commande séquentielle doit faire transiter cette charge analogique

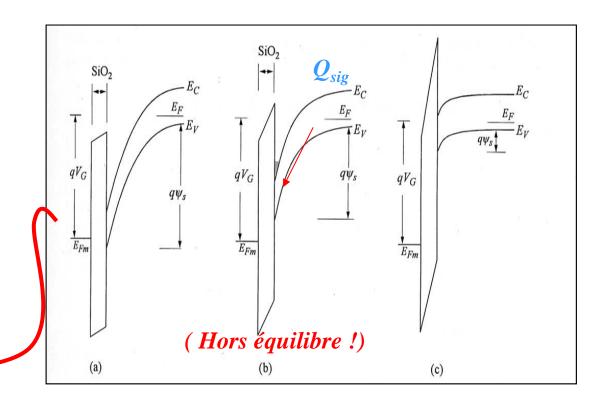
### Chronologie des CCD (d'après Ng)



- 1969: Boyle et Smith des Bell Labs inventent les CCD
- 1970: recherche intensive sur les CCDs
- 1971: première caméra CCD noir et Blanc
- 1972: Bell Labs annoncent une caméra couleur
- 1973: caméra CCD sur le marché
- 1974: brevet sur les CCDs décerné à Boyle et Smith
- 1975: caméra CCD avec résolution télévision
- 1976: première utilisation de caméra CCD pour l'astronomie (université d'Arizona) ⇔ énorme progrès dans la détection
- 1977: mémoire 64 Kbits TI avec CCDs
- Début années 80: la taille des capteurs CMOS ⇔ concurrent

### Rappel: déplétion profonde

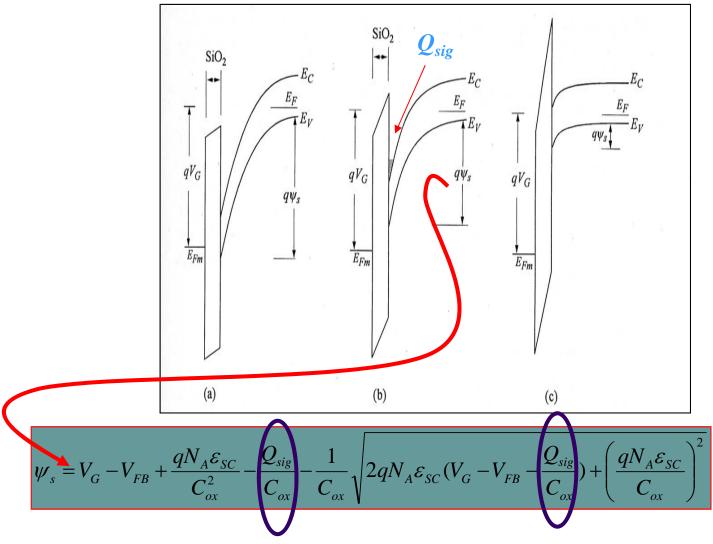




$$\psi_{s} = V_{G} - V_{FB} + \frac{qN_{A}\varepsilon_{SC}}{C_{ox}^{2}} - \frac{1}{C_{ox}}\sqrt{2qN_{A}\varepsilon_{SC}(V_{G} - V_{FB}) + \left(\frac{qN_{A}\varepsilon_{SC}}{C_{ox}}\right)^{2}}$$

### Rappel: déplétion profonde





### Rappel: déplétion profonde



SiO<sub>2</sub>

$$qV_{G}$$

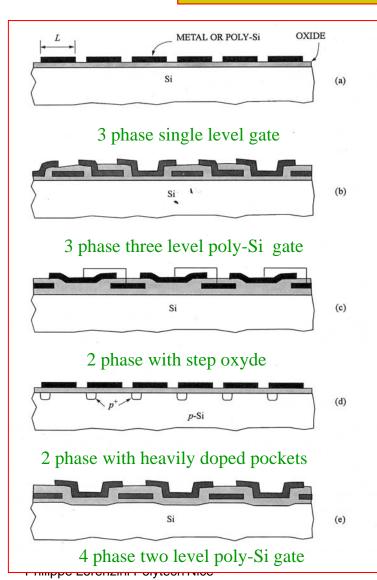
$$qV_$$

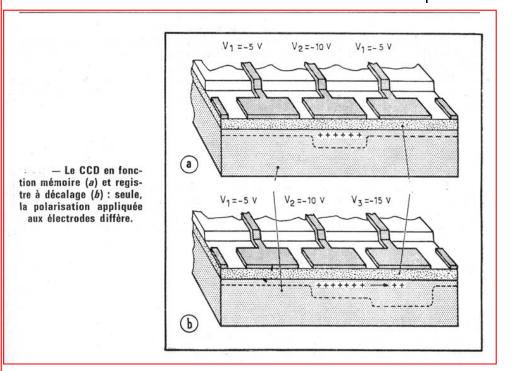
$$Q_{\text{max}} \approx C_{ox} V_G \iff \psi_s = \frac{2kT}{e} \ln(\frac{N_A}{n_i})$$
  
charge max  $\approx 10^{11} \ porteurs / cm^2$ 

Ex: carré de  $10 \, \mu m \Leftrightarrow 10^5 \, porteurs$ Détection minimale :  $20 \, porteurs \Leftrightarrow dynamique$  de  $10^4$ .

### Réalisation







Dispositifs à CCDs



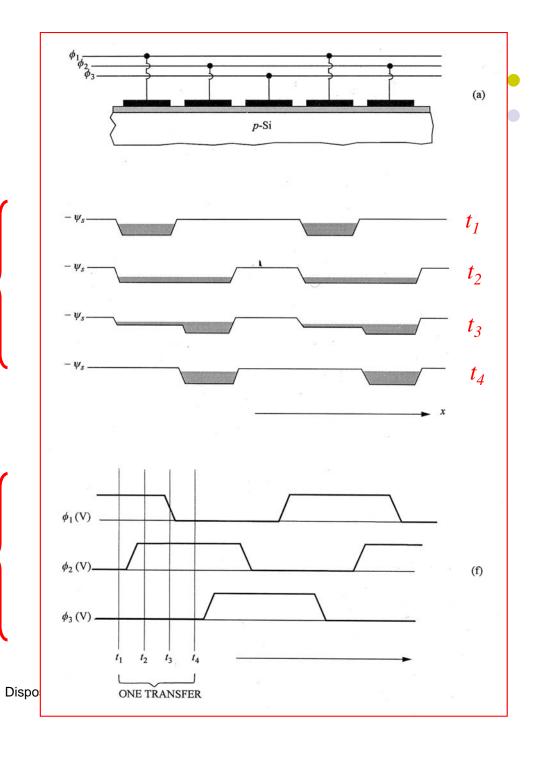
### Mécanisme de transfert de charges

- Un cycle d'horloge adapté doit permettre de faire transiter les charges vers les capacités adjacentes.
- Un exemple avec un cycle d'horloge à 3 phases permet un tel transfert de paquets de charge.

### Illustration du transfert de charges

Potentiel de surface en fonction de x aux différents temps

Tensions sur les différentes grilles



Philippe Lorenzini Polytech'Nice Sophia

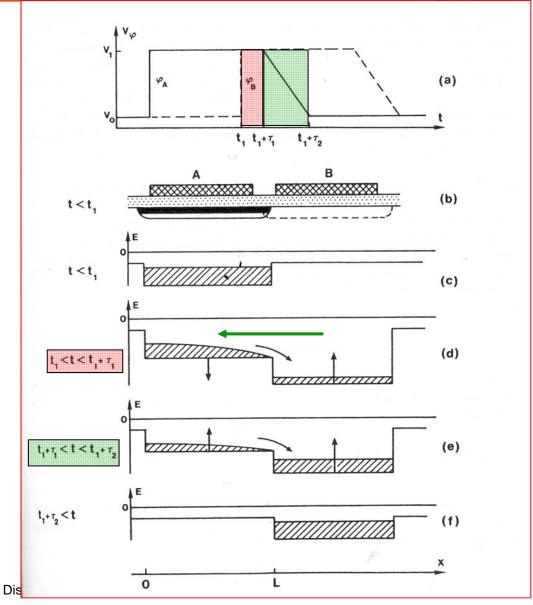
#### Temps de transfert et limitation



- 3 mécanismes contribuent au transfert:
  - Champ auto induit (« self induced drift ») du à la différence de concentration entre les 2 puits adjacents. Compte pour environ 98% à 99% du processus global de transfert
  - Diffusion thermique
  - Effet du champ de bord (« fringing field)

Les deux derniers ont des constantes de temps bcp plus longues

Philippe Lorenzini Polytech'Nice Sophia





### Transfert par champ auto induit

 Durant le transfert de charge, le potentiel de surface en présence de charges d'inversion varie (la charge dans le puits variant):

$$V_s(x,t) = V_G - \frac{e}{C_{ox}} n(x,t)$$

 Le champ auto induit est donné par :

$$E_{s} = -\frac{\partial V_{s}(x,t)}{\partial x} = \frac{e}{C_{ox}} \frac{\partial n(x,t)}{\partial x}$$

 Le courant associé au déplacement de ces charges (champ et diffusion) s'écrit:

$$j_n(x,t) = \mu_n en(x,t) E_s(x,t) + eD_n \frac{\partial n(x,t)}{\partial x}$$





• L'équation de continuité s'écrit (g = r = 0)

$$\frac{\partial n(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[ \left( \frac{\mu_n e}{C_{ox}} n(x,t) + D_n \right) \frac{\partial n(x,t)}{\partial x} \right] = \frac{\partial}{\partial x} \left( D_{eff} \frac{\partial n(x,t)}{\partial x} \right)$$

$$D_{eff} = D' + D_n \text{ avec } D' = \frac{\mu_n e}{C_{ox}} n(x,t) \text{ et } \frac{D'}{D_n} = \frac{en(x,t)/C_{ox}}{kT/e}$$

Au début du transfert, le puits est plein (D'>>D<sub>n</sub>) ⇔ transfert par champ auto induit, vers la fin, n(x,t) tend vers 0 et D<sub>eff</sub> #D<sub>n</sub> et le transfert est assuré par la diffusion thermique.

### Transfert par champ auto induit



 Le début du transfert est donc régi par le champ:

$$\frac{\partial n(x,t)}{\partial t} = \frac{\mu_n e}{C_{ox}} \frac{\partial}{\partial x} \left( n(x,t) \frac{\partial n(x,t)}{\partial x} \right)$$

 Séparation de variables

$$n(x,t) = g(t)h(x)$$

Nouvelle équation

$$\frac{1}{g^{2}(t)} \frac{dg(t)}{dt} = \frac{\mu_{n}e}{C_{ox}} \frac{1}{h(x)} \frac{d^{2}}{dx^{2}} (h^{2}(x))$$

### Constante de temps par champ auto induit



On arrive alors:

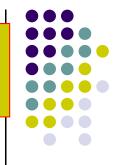
$$\frac{1}{g^{2}(t)} \frac{dg(t)}{dt} = -A \text{ soit finalement } g(t) = \frac{t_0}{t - t_0} g_0$$

 On montre que t<sub>0</sub> dépend de la structure du CCD (Mathieu) et s'écrit

$$t_0 \approx 2L^2 C_{ox} / \pi \mu_n e n_0$$

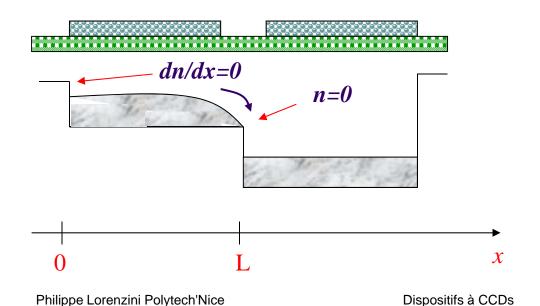
L: longueur d'1 capacité n<sub>0</sub> : population initiale

### Transfert par diffusion thermique



 Dans ce cas (fin du transfert D<sub>eff</sub> #D<sub>n</sub>), soit:

$$\frac{\partial n(x,t)}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 n(x,t)}{\partial x^2}$$



Sophia



$$n(t) = \frac{2a_0 L}{\pi} e^{-t/\tau_d}$$

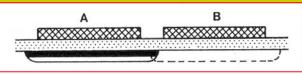
$$\tau_d = 4\tau_t / \pi^2 \approx \tau_t / 2$$

$$\tau_t = L^2 / D_n \text{ (temps de transit)}$$

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L n(x,0) \cos \frac{\pi x}{2L} dx$$

### Transfert par effet de bord (fringing

effect)





- Origine due à la présence des grilles adjacentes qui influe sur le potentiel de surface de la grille étudiée!
- Le champ de bord est fonction de la distance par rapport à la surface et est maximum autour d'une profondeur de L/2 (voir Ng)
- Il a le même sens que le champ auto induit

Constante de temps:

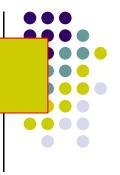
$$t = \frac{0.31L^3}{\mu V_G x_{ox}} \left( \frac{\varepsilon_{ox}}{\varepsilon_{SC}} \right)$$

# Choix de la période (ou fréquence) de l'horloge



- 3 critères (facteurs):
  - Permettre le transfert des charges sans en « oublier »
  - Période suffisamment courte devant le temps de stockage ou temps de relaxation thermique
  - Petite devant le signal analogique (1/f) à transmettre



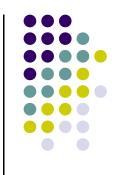


 Temps de mise en équilibre de la structure (entre la déplétion profonde et la forte inversion)
 temps de création de la couche d'inversion.
 C'est cet intervalle de temps qui est exploité dans les CCDs.

$$\tau_S \approx 2 - 10 \tau \frac{N_A}{n_i}$$

n<sub>i</sub> variant exponentiellement avec la température, on augmente exponentiellement le temps de stockage en refroidissant le composant.

### Inefficacité de transfert :



- Au bout d'une période d'horloge, il est évident qu'il existe encore une fraction de charges non transférée.
  - Efficacité de transfert:

$$\eta = (n(0) - n(T)) / n(0) = 1 - n(T) / n(0)$$

Inefficacité de transfert:

$$\varepsilon = 1 - \eta = n(T) / n(0)$$

### Dépendance en fréquence du rendement de sortie

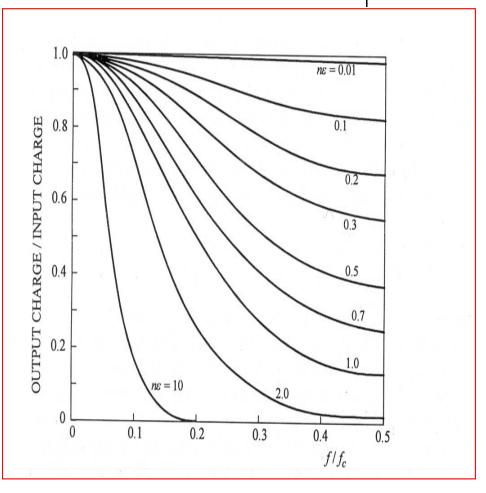


$$\frac{Q(sortie)}{Q(entrée)} = \exp\left[-n\varepsilon\left\{1 - \cos\left(\frac{2\pi f}{f_c}\right)\right\}\right]$$

- *n* nombre de transfert
- $\varepsilon$  perte de charge ou inefficacité de transfert à chaque transfert
- $f_c$  fréquence d'horloge
- f signal analogique à transférer

### Dépendance en fréquence du rendement de transfert

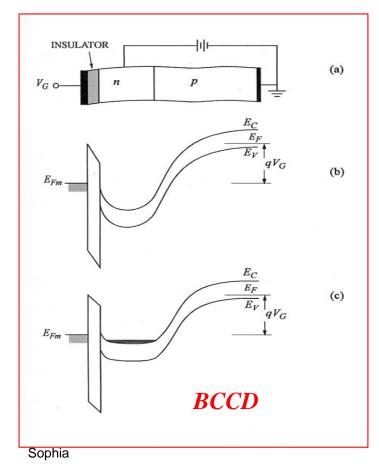
- Plusieurs facteurs limitent l'efficacité de transfert
  - Décroissance exponentielle de la charge durant le transfert ⇔ transfert non complet pour un temps fini
  - Piégeage des charges à l'interface Si-SiO<sub>2</sub> (piégeage rapide, dépiégeage lent)
    - Solution: injection de charge de saturation des pièges mais réduction du SNR
    - Éloigner les charges de l'interface par des structures BCCD, PCCD et P<sup>2</sup>CCD

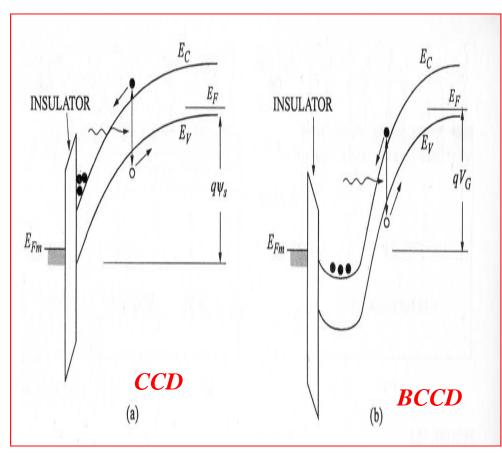


### el»)

#### Dispositifs à canal enterré (« buried channel »)

 Intérêt: éloigner les paquets de charges de l'interface



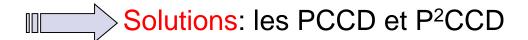


#### Les BCCDs -d o Si(n) Si(p) (b) E<sub>F</sub> V = 0V<sub>G</sub>=0 Si(n) Si(p) (a) (c) (d) E<sub>F, DOCCOURS</sub> V>0 $V_G = 0$ (e) w≥t+xn Électrons (f) (d) ⇔ On doit les faire disparaître $V > V_T$ On amincit la couche n de façon à joindre les 2 ZCE. Dispositifs à CCDs Philippe Lorenzini Polytech'Nice Sophia



### Avantages et inconvénients des BCCDs.

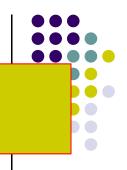
- Avantages:
  - Porteurs en volume
    - Effet d'interface réduit
    - Mobilité en volume 
       les électrons vont plus vite qu'en surface
- Inconvénient:
  - Densité de charge plus faible
    - Division par 2 à 3 de la taille des paquets



### Les Péristaltic CCD et Profiled-Peristaltic CCD

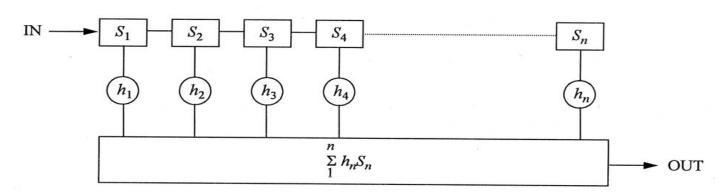


- Architecture:
  - Double canal n
    - en surface
    - en volume
- Double charge
  - En surface : grande densité transférable
  - En volume: vitesse et éloignement de l'interface
- Au début, les charges sont transférées rapidement (champ auto induit), la dernière fraction (qq %) est stockée dans le volume et transférée par le mécanisme des BCCDs.
- Dans le cas des P<sup>2</sup>CCDs, la surface est dopée par un double profil, ce qui permet de garder les charges loin de l'interface.



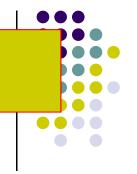
### **Application des CCDs**

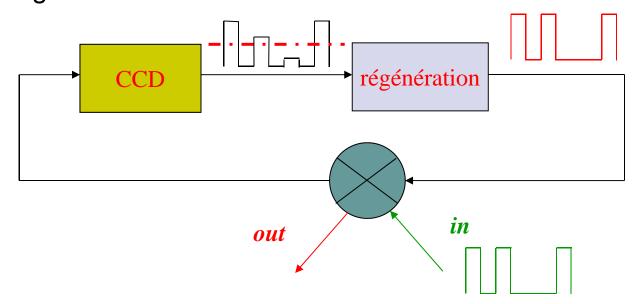
- Lignes à retard: le retard est déterminé par la fréquence d'horloge et le nombre d'étages (de cellules)
- Traitement du signal: filtres transversaux



Filtres transversaux

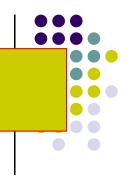
### **Applications (suite)**



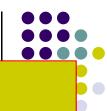


 Comme les CCDs sont par nature d'architecture série, les temps d'accès sont très réduits

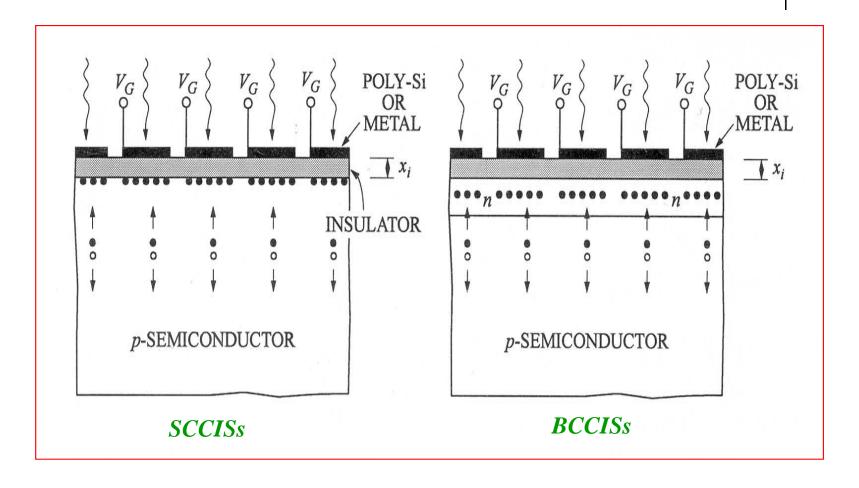
### **Applications (suite)**



- - Charge Coupled Image Sensor (ou Solid State Sensor)
- Principe: transférer l'information collectée par des photo détecteurs sous format série.
- Les CCDs peuvent à la fois extraire un signal analogique mais également être sensible à la lumière.



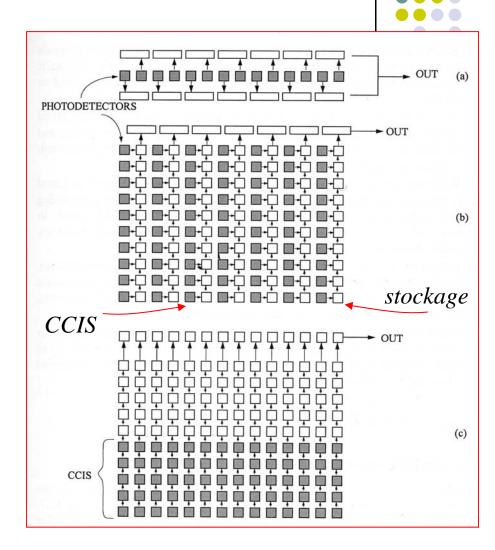
### **Imagerie:**

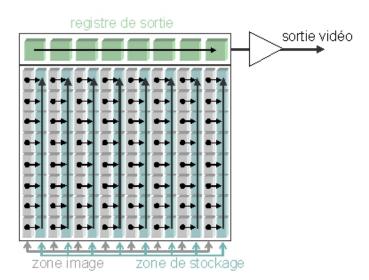


### **CCISs**

- a) Ligne de CCDs (ou CCISs) avec 2 registres de sortie.
- b) Capteur 2D avec transfert interligne(plus rapide)
- c) Capteur 2D avec réseau de transfert (densité de pixels plus grandes mais rendu de l'image moins bon)

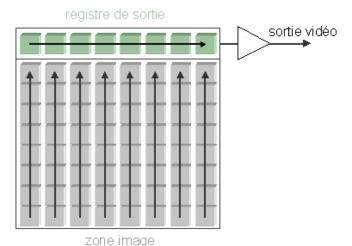
Les registres de sorties sont cadencés à une fréquence plus rapide que la fréquence de transfert interne





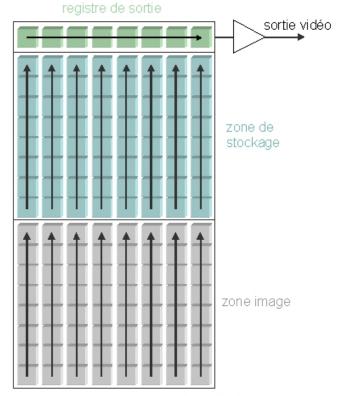
Transport des charges avec un capteur à transfert interligne

- 1) les charges sont transférées dans les colonnes de stockage
- 2) les charges sont transférées vers le registre de sortie
- 3) les charges sont évacuées en série



Transport des charges avec un capteur à transfert parallèle-série :

- après le temps d'intégration, l'obturateur est fermé et les charges sont transférées dans le registre horizontal
- 2) les charges sont évacuées en série



Transport des charges avec un capteur à transfert de trame

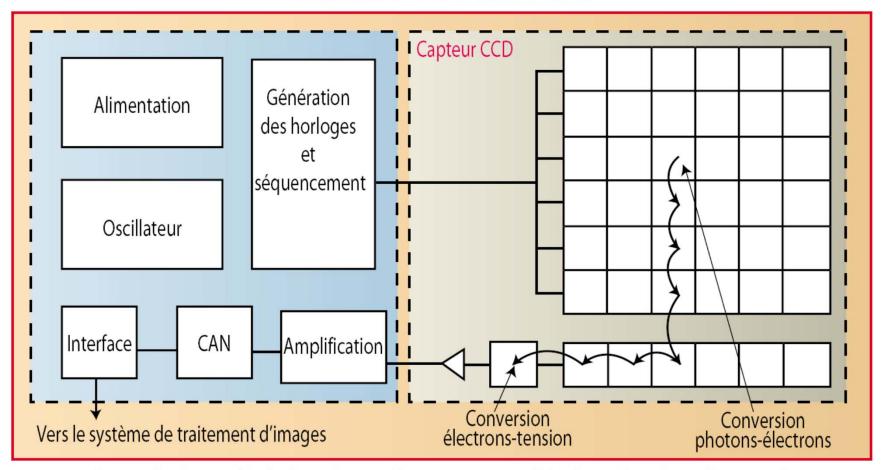
- 1) les charges sont transférées dans la surface de stockage
- 2) les charges sont transférées vers le registre de sortie
- 3) les charges sont évacuées en série

http://www710.univ-lyon1.fr/~fdenis/club\_EEA/cours/acq\_capteurs.html

### **CCISs**



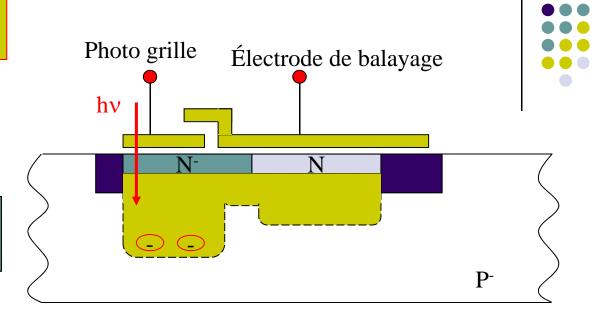
#### CAMÉRA À CAPTEUR CCD



Dans une caméra CCD, les charges collectées durant le temps d'exposition sont transférées, de pixel à pixel, jusqu'à un point de sortie unique où elles sont converties en tension. La matrice est donc "lue" ligne à ligne, dans l'ordre. Le signal de sortie du composant est analogique.

### **CCISs**

Intégration de la lumière



Transfert au CCD

hv PDispositifs à CCDs

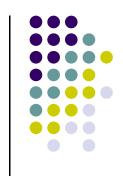
Philippe Lorenzini Polytech'Nice Sophia 33





- L'architecture des CCISs va dépendre de la méthode de traitement du signal vidéo (en ligne, par paquets,...)
- Quelques exemples:
  - Amplificateur à grille flottante
  - Analyse à décharge de photodiode
  - Analyse linéaire
  - Analyse d'image
  - •

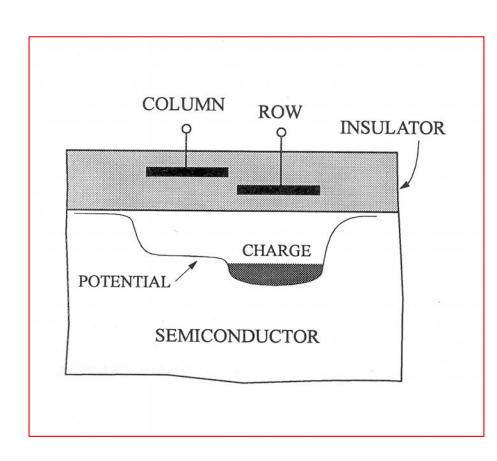
# Dispositif à injection de charges (CIDs)



- En fait, même structure que les CCISs.
- La différence essentielle est dans le mode de lecture:
  - CCIS: transfert latéral des charges
  - CID: transfert des charges dans le substrat
- Dans le mode « image », l'adressage x-y est assuré par la réalisation de 2 puits.

## Dispositif à injection de charges (CIDs) (d'après Ng)

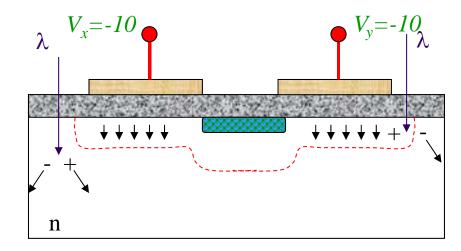




- Les 2 puits sont très proches, les photo - porteurs peuvent être transférés d'une cellule à l'autre.
- Lorsque les deux grilles sont polarisées de telle sorte que la surface est en accumulation, les charges sont injectées vers le substrat.



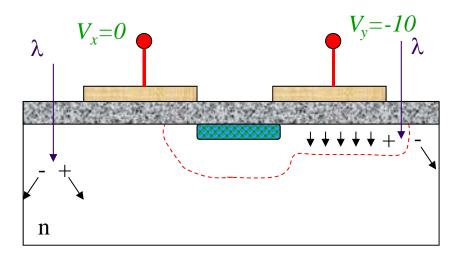




•Les deux MOS sont en inversion (en fait déplétion profonde) ⇔ les photo – porteurs sont collectés sous les deux grilles.



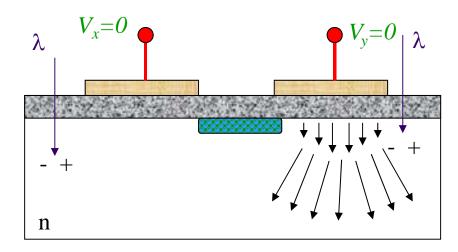
#### Principe du CID



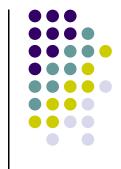
•Une des 2 grilles est amenée à « 0 » ⇔ les charges s'accumulent sous une seule grille.



#### Principe du CID

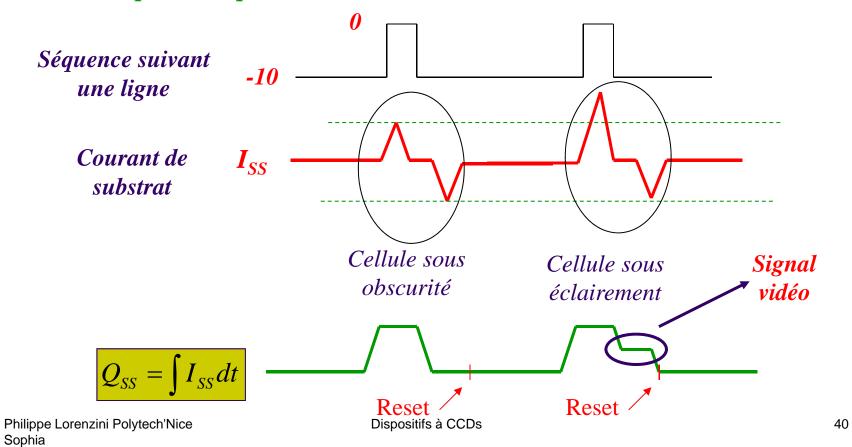


•La polarisation a disparu ⇔ les charges sont évacuées par le substrat ⇔ un courant apparaît dans le substrat proportionnel à la charge donc à la lumière.



#### Principe du CID

Signaux de commande de lecture de réseau , pour un axe de lecture par exemple x

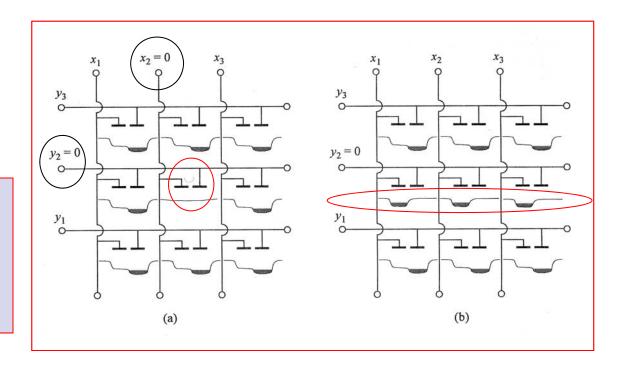


# Dispositif à injection de charges (CIDs) (d'après Ng)



Pixel: point image

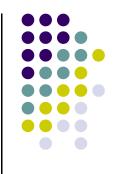
- Accès aléatoire
- •Pas de transfert obligatoire
- •Efficacité de transfert non critique



Pixel (2,2) sélectionné

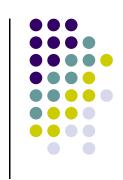
Ligne y<sub>2</sub> sélectionnée

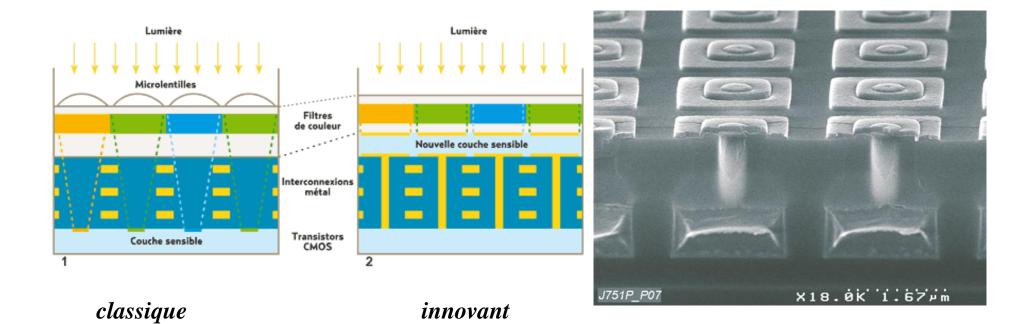




- Excellentes performances:
  - Résolution / vitesse / Bruit / Uniformité
  - Maturité / marché bien identifié
  - Technologie de choix pour:
    - caméscopes haut de gamme et caméras numériques
    - science, astronomie, médical, ...
- Mais:
  - plusieurs sources de tension
  - consommation
  - technologie propriétaire
  - pas d'électronique intégrée
  - Rendement faible (50% de la surface : métal )

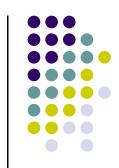
# Surface 100% utile! (Leti-CEA/STm)

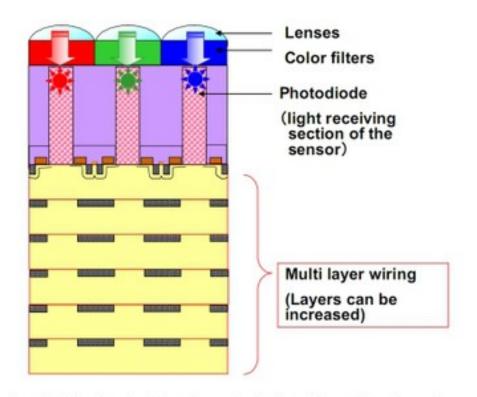




http://www.cea-technologies.com/article/article.php?article=579#

# capteur CMOS Toshiba 14.6 mégapixels



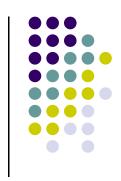


The lenses are attached to the back side of a substrate with a planed surface, and deliver light directly to the photodiodes. With no interference from wiring, light sensitivity and overall performance are boosted.

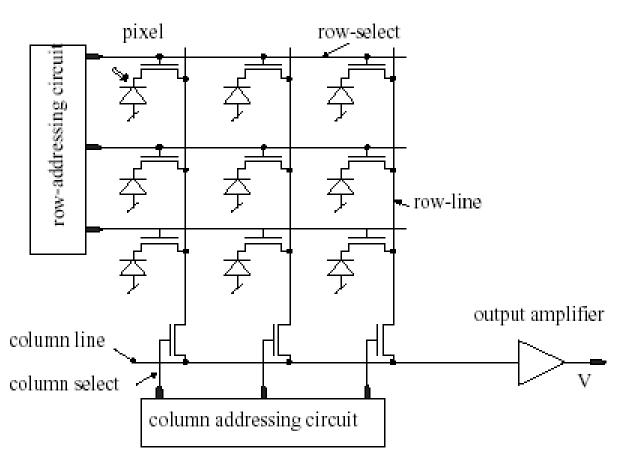


## Les capteurs CMOS

- Avantages:
  - Procédés de fab. Standards
  - Consommation (/100 CCD)
  - Taille:
  - Ressources en Design
  - Pixels adressables
  - Intégration « on chip » du traitement du signal
- Inconvénients:
  - Courant d'obscurité
  - Bruit
  - uniformité



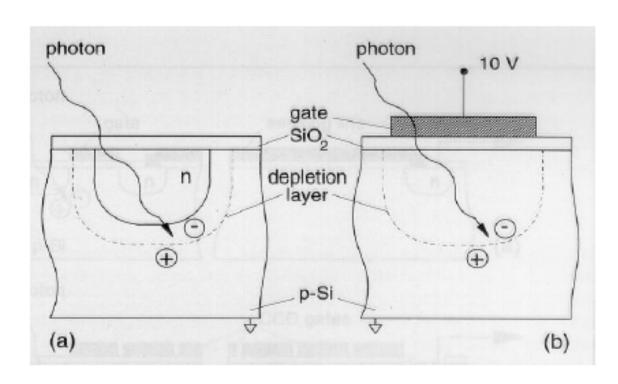
#### **Structures**





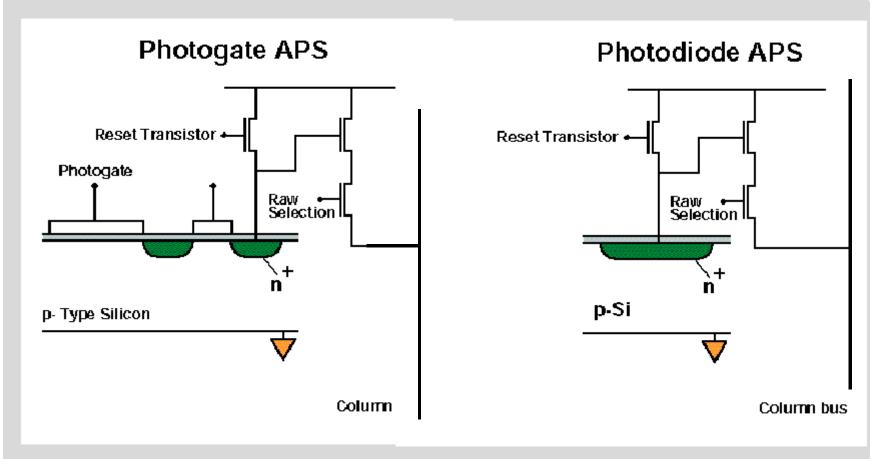
### Structures: collection des charges

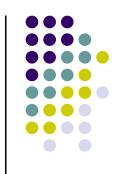
pn junction photodiode array MOS Capacitor photogate



### Lecture du signal:

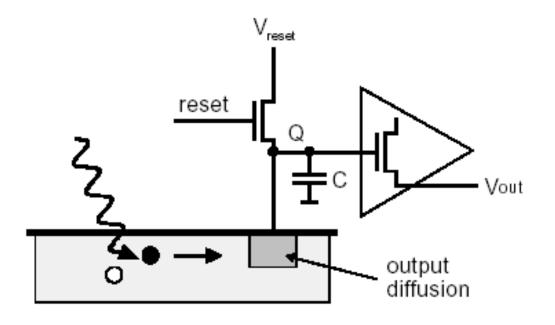






Output signal:  $V_{out} = Q / C$ 

For C = 40 fF, conversion gain:  $q / C = 4 \mu V/e$ 



# **Bibliographie**



- Kwok K. Ng, « complete guide to semiconductor devices», McGraw-Hill, 1995
- *H. Lilen*, « circuits intégrés JFET-MOS-CMOS, principes et applications », éditions radio, 3° édition, 1979
- H. Mathieu, « Physique des semiconducteurs et des composants électroniques », Masson, 4° édition, 1998.